

首届先进电子封装材料技术论坛在深圳召开

文章来源：深圳先进技术研究院

发布时间：2013-11-18

【字号：小 中 大】

11月18日，中国科学院深圳先进技术研究院“先进电子封装材料”广东省创新团队（以下简称“创新团队”）第一届电子封装材料技术论坛在深圳市会展中心召开。本次论坛以“新一代电子封装关键材料的开发与产业化”为主题，深入探讨我国电子封装材料与模式，商议建立畅通的产学研合作渠道。先进院院长助理、产业发展与资源处处长毕亚雷主持论坛开幕仪式。

先进院院长樊建平在致辞中表示，国家已经注意到集成电路产业是培育发展战略性新兴产业、推动信息化和工业化深度融合的核心与基础，是转变经济发展方式、调整信息产业结构、扩大信息消费、维护国家安全的重要保障。但现在国内集成电路产业的大部分关键材料仍依赖进口，产业发展受制于人。先进院作为开放式平台化操作的研究院，引进“先进电子封装材料”广东省创新团队，开展面向高密度系统级封装材料的研发与产业化，力争为我国集成电路产业的发展提供动力。

论坛专题报告会由创新团队执行负责人孙蓉研究员主持。创新团队负责人、美国国家工程院院士、香港中文大学学院院长、美国佐治亚理工学院董事教授汪正平教授首先作报告，介绍了先进电子封装技术与关键材料的历史和挑战。汪正平教授长期从事封装技术及材料开发研究，被誉为“现代半导体封装之父”，其研究领域包括IC封装特别是密封等效封装、电子加工封装和自组装加工、界面粘附和纳米功能材料，在封装材料领域已发表学术论文1000多篇，申请美国专利60余项，近五年来承担和参与各种项目近100项。

孙蓉研究员以聚合物基电子封装材料的开发与产业化为主题，详细介绍了创新团队研究方向和所取得进展，并向到场的企业嘉宾阐述了团队服务企业的理念，表示愿意同企业一起将中国的先进电子封装领域推向国际领先地位。香港科技大学先进微系统封装中心主任、创新团队核心成员李世玮教授向到场的观众介绍了先进电子封装制程、技术和材料的相互关系和技术前沿，并主持讨论了国内外在电子封装材料领域的差距、封装材料供应本土化的难点以及高校和研究院的研发成果难以产业化等困扰中国电子封装领域的难题。

本次论坛还请到包括华进半导体封装先导技术研究有限公司执行总裁上官东恺、德邦科技公司总经理陈田安、江苏华海诚科新材料有限公司董事长韩江龙、深南电路公司总工程师孔令文和技术有限公司产品工程主任规划师张源等国内著名电子领域企业嘉宾作报告。来宾就各自所关注领域如高密度封装基板材料、塑封材料、电子混合集成趋势等技术前沿进行了深入剖析，受到广泛关注。

中国科学院微电子所所长叶甜春、深圳市科技创新委员会处长涂欢及深圳市新材料协会会长陈寿等也出席论坛并致辞；国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟副秘书长曹立强、哈尔滨工业大学深圳研究生院材料科学与工程学院院长李明雨、东南大学教授尚金堂等也应邀出席论坛。



汪正平教授介绍先进电子封装技术与关键材料的历史和挑战



论坛现场

[打印本页](#)

[关闭本页](#)